

2021年3月期 第3四半期 決算説明資料



2021年2月5日



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

当社グループの報告セグメント

電子機器用部材事業 (電材事業)

PWB用部材を始めとする電子部品用
化学品部材の製造販売及び仕入販売



医療・医薬品事業 (医薬事業)

医療用医薬品・医療用医薬部外品
その他に関する開発・製造販売



その他事業

染料・顔料等の化学品の製造販売、
自然エネルギーによる発電事業及び
ソフトウェア開発等



2021年3月期 第3四半期 トピックス

電材事業

累計売上高は前年同期比で5%増加、四半期ベースで過去最高

主要因

- ・新型コロナウイルスによる在宅勤務、オンライン授業の拡大によってデータセンターやパソコンなど、電子機器の需要が高水準で推移
- ・自動車市場の復調により、車載用基板向け製品比率が高いリジッド高機能の売上高が伸長

電材事業

累計営業利益は前年同期比で18%増加

主要因

- ・半導体パッケージ基板向けDF製品比率の向上

医薬事業

累計売上高は前年同期比で53%増加（EBITDAは前年同期比149%増）

主要因

- ・ 2019年10月承継の太陽ファルマテックの寄与
- ・ 2020年4月にアストラゼネカより譲受した長期収載品4製品の寄与



連結業績

連結業績サマリ

単位：百万円

	① 2020年3月期 3Q累計 実績	② 2021年3月期 3Q累計 実績	②-① 前年同期比	(②-①) ÷① 増減率	③ 2021年3月期 11月6日発表 通期 業績予想	②÷③ 進捗率
売上高	52,312	60,460	+8,148	+16%	79,700	76%
営業利益	6,840	10,926	+4,086	+60%	12,000	91%
経常利益	6,701	10,816	+4,115	+61%	11,600	93%
親会社株主に帰属する当期純利益	4,964	7,706	+2,742	+55%	7,500	103%
円・USDレート	109.1	105.9	-3.2		105.0	
EBITDA	10,588	16,482	+5,894	+56%	19,200	
営業利益率	13%	18%			15%	
EBITDA マージン	20%	27%			24%	

2021年3月期 連結通期業績予想

セグメント別連結通期業績予想

単位：百万円

円・USD想定レート 105円

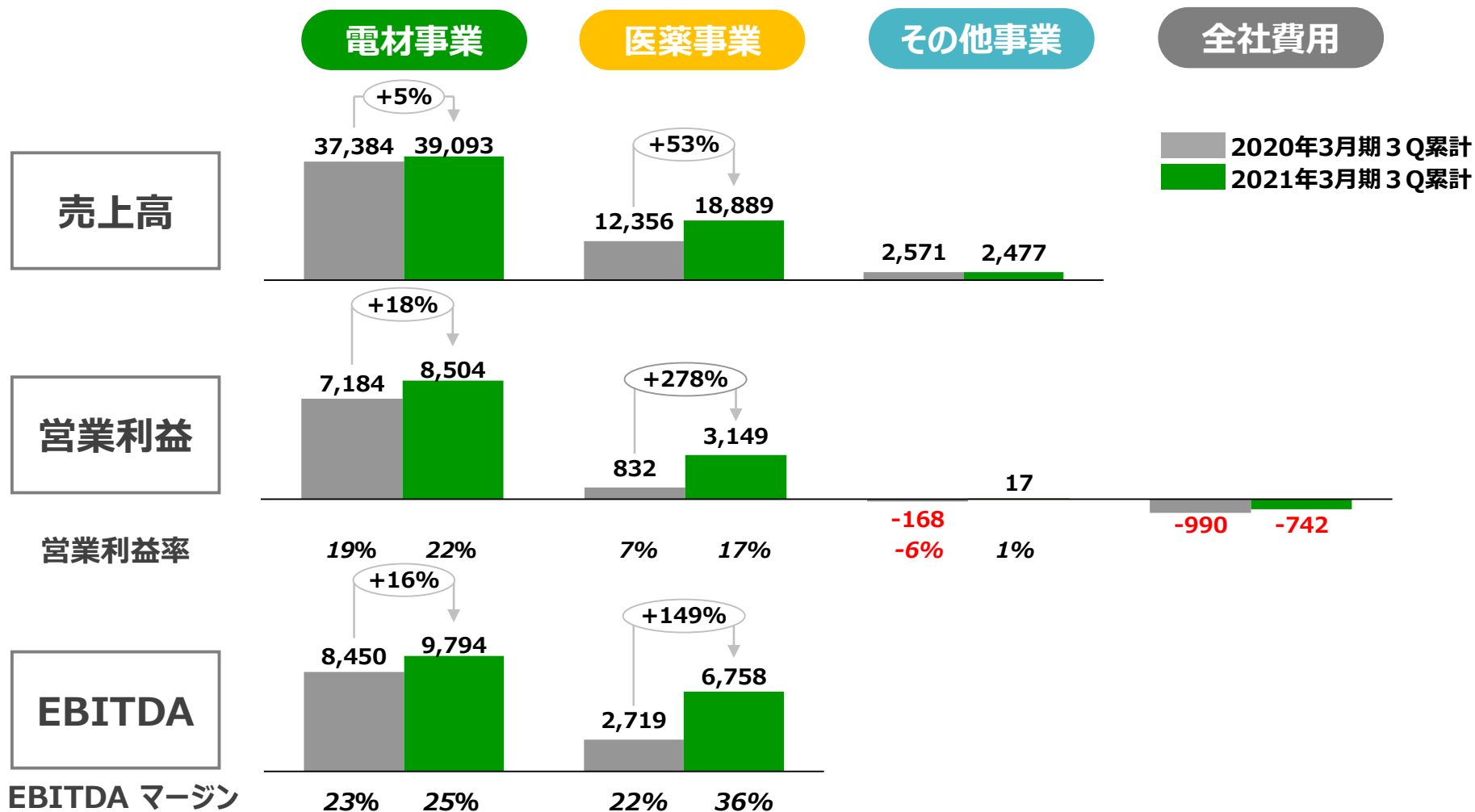
	2021年3月期 業績予想		
	今回発表		
	連結	電材事業	医薬事業
売上高	80,500	51,600	25,200
営業利益	13,300	10,700	3,500
EBITDA	20,700	12,400	8,300
営業利益率	16%	21%	14%
EBITDA マージン	26%	24%	33%

2021年3月期 業績予想		
11月6日発表		
連結	電材事業	医薬事業
79,700	50,400	25,600
12,000	9,500	3,600
19,200	11,100	8,300
15%	19%	14%
24%	22%	32%

セグメント別業績

セグメント別売上高・営業利益・EBITDA

単位：百万円

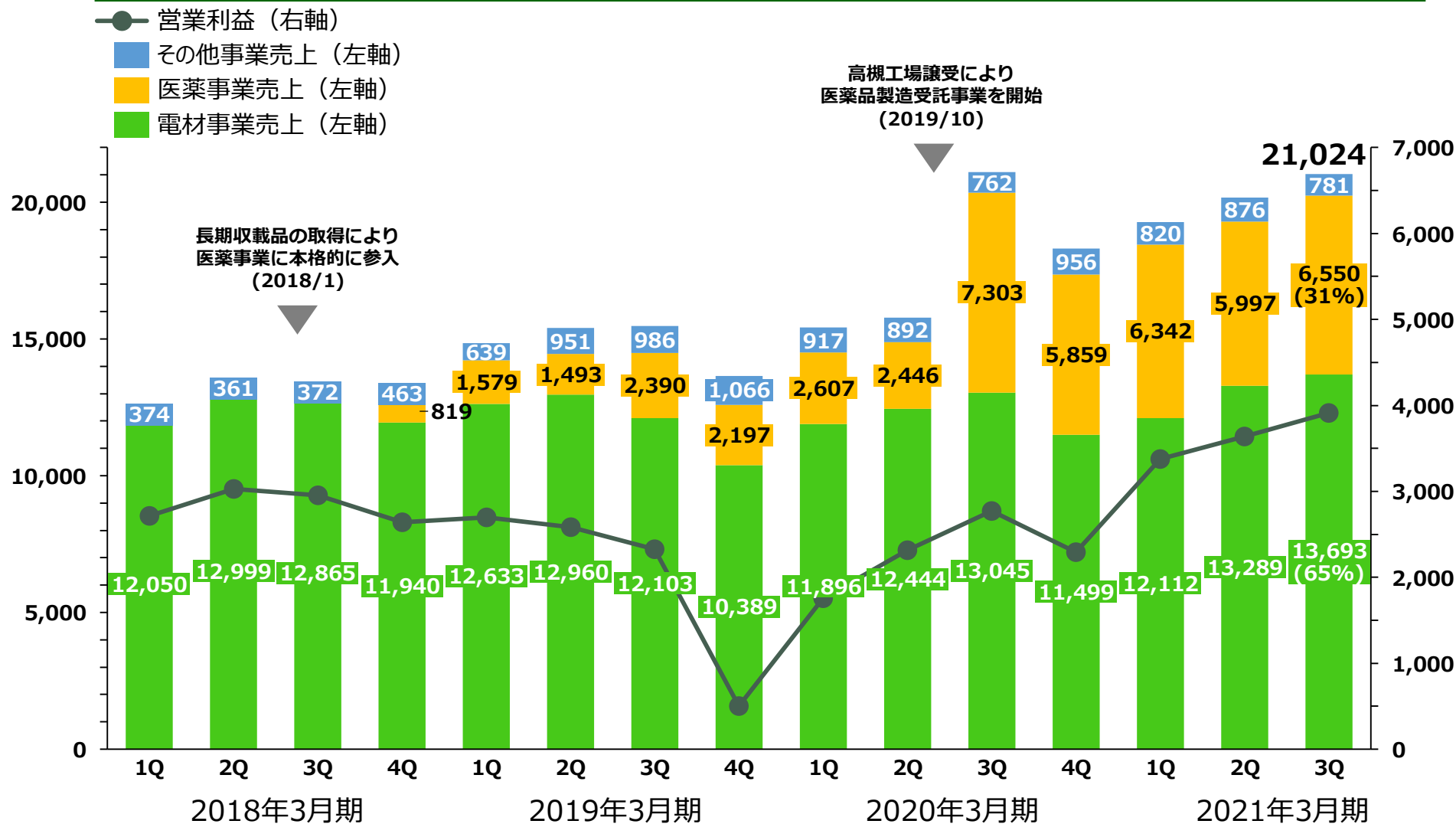


※前第3四半期より、従来は全社費用として差異調整に関する事項に含めていたのれんの償却額を、各報告セグメントに配分しています。また、当第1四半期より、従来は全社費用に含めていた一部費用を各報告セグメントに配分しています。なお、2020年3月期第3四半期のセグメント利益又は損失は、変更後の報告セグメントの利益又は損失の算定方法に基づき作成しています。

四半期別推移

四半期別推移：売上高/営業利益

単位：百万円



BSの概況

BS前期比較

単位：百万円

	20/3末	20/12末	増減
現金及び預金	29,191	52,507	23,316
受取手形及び売掛金	19,513	21,386	1,873
たな卸資産※1	11,408	12,704	1,296
その他	2,267	1,720	▲547
流動資産合計	62,380	88,317	25,937
有形固定資産	44,761	45,161	400
無形固定資産	30,769	35,312	4,543
その他	4,280	4,803	523
固定資産合計	79,811	85,277	5,466
資産合計	142,192	173,595	31,403

	20/3末	20/12末	増減
短期借入金※2	10,893	15,608	4,715
長期借入金	44,818	63,847	19,029
支払手形及び買掛金	7,231	8,044	813
その他	9,726	11,495	1,769
負債合計	72,668	98,994	26,326
株主資本	69,651	73,869	4,218
その他	▲429	395	824
非支配持分	301	335	34
純資産合計	69,523	74,600	5,077
負債純資産合計	142,192	173,595	31,403

自己資本比率	48.7%	42.8%	-5.9%
--------	-------	-------	-------

※1 たな卸資産：商品及び製品+仕掛品+原材料及び貯蔵品
※2 短期借入金：短期借入金+1年内返済予定の長期借入金

電子機器用部材事業

用語説明

用語	内容
PWB (Printed Wiring Board)	プリント配線板
SR (Solder Resist)	ソルダーレジスト（レジストインキ）
PKG (Package)	半導体パッケージ
DF (Dry Film)	ドライフィルム

電子機器用部材事業

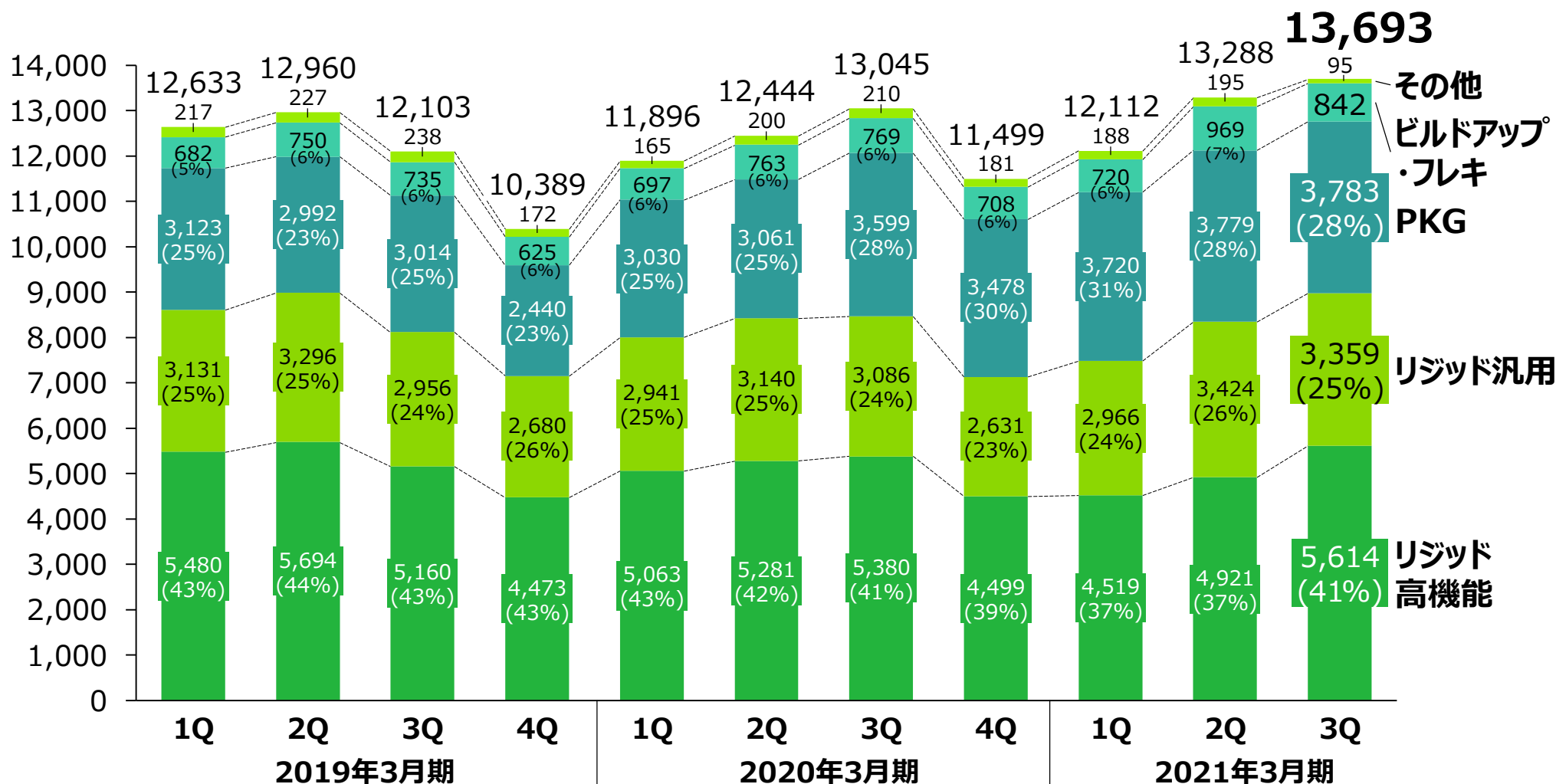
製品分野

分野	分類		性状	用途
PWB用 絶縁材料	リジッド	汎用品	液状	表層保護・絶縁用 SR材料
		高機能品	液状／DF	
	PKG		液状／DF	
	フレキ		液状／DF	
	ビルドアップ		液状／DF	層間絶縁・穴埋め用 ビルドアップ材料
その他 関連商材	その他		液状	マーキング・エッチング・めっき用材料 フラックス・溶剤等・導電性銀ペースト

電子機器用部材事業

製品区分別売上高

単位：百万円



TAIYO HOLDINGS CO., LTD.

12



TAIYO HOLDINGS CO., LTD.